**華南金融控股股份有限公司**

請單面列印

**個人資料保護法告知事項暨同意書**

華南金融控股股份有限公司(以下稱本公司)依據個人資料保護法(以下稱個資法)第八條第一項規定，向台端告知下列事項，敬請台端詳閱及知悉：

* 1. **蒐集之目的：**

本公司蒐集、處理與利用您的個人資料，目的係為「華南金控第二屆金融科技創新競賽」之參賽者管理、報名管理、身分確認聯繫、競賽活動訊息聯繫等相關行政作業，以及產學合作與人才交流等相關聯繫事項。

* 1. **蒐集之個人資料類別：**

包含姓名、身分證統一編號、聯絡方式(如電話號碼、通訊地址、居住地址、系所、單位、職稱、電子信箱等)及其他得以直接或間接識別您個人之資料。

* 1. **個人資料利用之期間、地區、對象及方式：**
1. 期間：個人資料蒐集之特定目的存續期間、依相關法令規定或契約約定之保存年限（如：商業會計法等）或本公司因執行業務所必須之保存期間。
2. 地區：下列「個人資料利用之對象」所列之利用對象其國內及國外所在地。
3. 對象：本公司及其子孫公司(包含華南商業銀行股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、華南產物保險股份有限公司、華南永昌證券投資信託股份有限公司、華南金資產管理股份有限公司、華南金創業投資股份有限公司、華南期貨股份有限公司、華南國際租賃股份有限公司、華南證券投資顧問股份有限公司)、業務委外機構、司法機關及其他依法有調查權機關或金融監理機關。
4. 方式：以自動化機器或其他非自動化方式所為之利用。
5. **當事人權利與行使方式：**

台端就本公司保有之個人資料，得向本公司要求行使下列權利：

1. 請求查詢、閱覽或製給複製本，本公司依法得酌收必要成本費用。
2. 請求補充或更正，惟依法台端應為適當之釋明。
3. 請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除，惟依法本公司因執行業務所必須者，得不依台端請求為之。
4. **不提供個人資料所致權益之影響：**

台端得自由選擇是否提供相關個人資料，惟台端若拒絕提供或未提供正確之相關個人資料，本公司將無法受理您的報名，敬請見諒。

經貴公司向本人告知，本人已清楚瞭解並同意貴公司蒐集、處理、利用本人個人資料之目的及用途，且同意貴公司於上開告知事項所列之必要範圍內，得蒐集、處理及利用本人之個人資料。

立同意書人(簽名或蓋章)：

中 華 民 國 年 月 日

**財團法人資訊工業策進會**

請單面列印

**蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書**

版本：P- CM17020033-DATA

**財團法人資訊工業策進會(下稱本會)**因執行華南金控第二屆金融科技創新競賽，為遵守個人資料保護法令及本會個人資料保護政策、規章，於向您蒐集個人資料前，依法向您告知下列事項，敬請詳閱。

1. 蒐集目的及類別

本會因執行競賽業務、活動、計畫、提供服務及供本會用於內部行政管理、陳報主管機關或其他合於本會捐助章程所定業務、寄送本會或產業相關活動訊息之蒐集目的，而需獲取您下列個人資料類別：姓名、聯絡方式(如電話號碼、職稱、電子信箱、居住或工作地址等)、身分證統一編號，或其他得以直接或間接識別您個人之資料。

※您日後如不願再收到本會所寄送之行銷訊息，可於收到前述訊息時，直接點選訊息內拒絕接受之連結。

1. 個人資料利用之期間、地區、對象及方式

 除涉及國際業務或活動外，您的個人資料僅供本會於中華民國領域、在前述蒐集目的之必要範圍內，以合理方式利用至蒐集目的消失為止。

1. 當事人權利

您可依前述業務、活動所定規則或依本會網站（http://www.iii.org.tw/）「個資當事人行使權利專頁」公告方式向本會行使下列權利：

1. 查詢或請求閱覽。
2. 請求製給複製本。
3. 請求補充或更正。
4. 請求停止蒐集、處理及利用
5. 請求刪除您的個人資料。
6. 不提供個人資料之權益影響

若您未提供正確或不提供個人資料，本會將無法為您提供蒐集目的之相關服務。

1. 您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本會留存此同意書，供日後取出查驗。

**個人資料之同意提供：**

一、本人已充分獲知且已瞭解上述貴會告知事項。

1. 本人同意貴會於所列蒐集目的之必要範圍內，蒐集、處理及利用本人之個人資料。

**＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝**

**您是否願意收到本活動之主辦單位未來舉辦的相關活動訊息？□願意　□不願意**

 **(註：未勾選者視為＂不願意＂)(** 如您勾選願意後，日後不願再收到本會所寄送之相關活動訊息，可於收到前述訊息時，直接點選訊息內拒絕接受之連結。**)**

立同意書人：

中華民國年月日